★シリコン材料・デバイス研究会（SDM）

専門委員長　国清辰也　副委員長　品田高宏
幹事　黒田理人・山口　直　幹事補佐　池田浩也・諸岡　哲

日時　2月8日（木）　10：00～16：55
会場　東京大学本郷キャンパス
議題　配線・実装技術と関連材料技術

1.〔招待講演〕　クラスター気相合成法で形成したWSin（n＝12）挿入膜を用いたCu直接コンタクト
　○岡田直也・内田紀行・小川真一・遠藤和彦・金山敏彦（産総研）
2.〔招待講演〕　サブ10 nmのFinFETにおける低コンタクト抵抗実現に向けたコバルト合金の特性
　○小池淳一・マリャムサダト ホセイニ・安藤大輔・須藤祐司（東北大）
3.〔招待講演〕　銅配線のためのグラフェンキャップ膜の耐湿バリア性
　○上野和良・ゴマサン プロイブッサラ・阿部拓実（芝浦工大）・河原憲治（九大）・和才容子・ナバトワ-ガバイン ナタリヤ（堀場製作所）・グエン タン クン（物質・材料研究機構）・吾郷浩樹（九大）・岡田　晋（筑波大）

午後（13：10～）

4.〔招待講演〕　ウェハボンディング技術における接合界面への絶縁膜中水分の影響とSiCN膜による抑制効果
　○手谷道成・森永泰規・浜田政一・竹内雅彦・宇家眞司・矢野　尚・佐藤直昭・松本　晋（パナソニック・タワージャズ）
5.〔招待講演〕　界面活性剤によるCo表面の防食挙動解析
　○柴田俊明・草野智博・原田　憲・竹下　寛・河瀬康弘（三菱ケミカル）
6.〔招待講演〕　車載用低コストはんだTSV技術　　○水谷厚司・大原悠希・稲垣優輝・浅海一志（デンソー）
7.〔招待講演〕　CuナノスケールおよびSn-Bi共晶粉末を用いた過渡液相焼結法による低温Cu-Cu接合
　○ムハマド ハイリ ファイズ・番匠一馬（早大）・須賀唯知（東大）・宮下朋之・吉田　誠（早大）
8.〔招待講演〕　分子接合技術による次世代配線形成　　八甫谷明彦（東芝）

◆応用物理学会共催
☆SDM研究会今後の予定　〔　〕内発表申込締切日
　2月28日（水），3月1日（木）北大百年記念会館〔締切済〕テーマ：機能ナノデバイス及び関連技術

【問合先】

黒田理人（東北大）
　TEL〔022〕795-4833，FAX〔022〕795-4834
　E-mail：rihito.kuroda.e3@tohoku.ac.jp